

2026年09月22日

主題趨勢報

台灣股市

台股5萬，只欠東風



報告摘要

- 台股量縮震盪，基本面好，短期因素干擾
- SEMICON Taiwan 2026聚焦於AI半導體、先進封裝與矽光子技術
- 蘋果新機發表，看摺疊機帶動零組件規格升級

投資聲明:本研究報告由永豐商業銀行提供，資料來源為永豐證券投資顧問股份有限公司，所載資料僅供參考，無法保證內容完整性或預測正確性，亦不作任何保證，資料內容若有變更，將不另行通知，客戶投資前應慎審考量本身風險承受度，並應自行承擔投資風險。投資均有風險，任何投資商品過去績效亦不代表未來績效之保證，且有可能受市場波動導致本金損失；若申購以外幣計價的投資商品應瞭解匯率變動風險亦有可能導致本金之損失。未經永豐商業銀行及永豐證券投資顧問股份有限公司同意，不得以任何形式沿用、複製或轉載本文件之內容。

2026年09月22日

主題趨勢報

台股站穩高檔，下一步怎麼看？

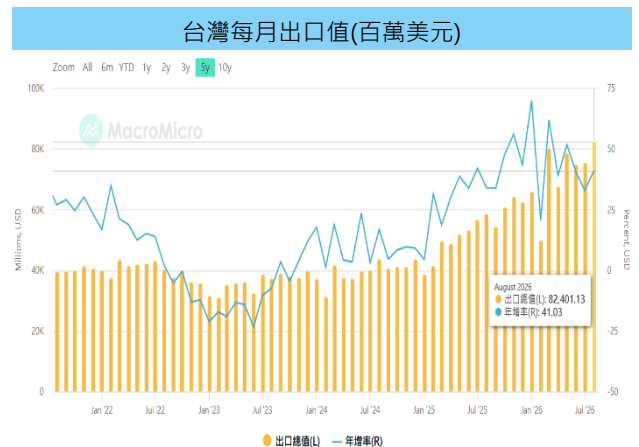
九月以來，台北股市在八月出現一波強勁反彈後，逐漸進入高檔整理格局。指數大多時間於46,000點附近震盪，雖然盤中一度突破47,000點整數關卡，創下波段新高，但在獲利了結賣壓及國際局勢干擾下，市場追價意願並未明顯升溫，成交量亦呈現萎縮現象。整體而言，目前台股已從先前急漲階段轉向區間整理，投資人對於後續基本面與國際變數的拉鋸抱持觀望態度。

從基本面來看，支撐台股的重要因素並未改變。首先，**台灣出口表現持續優於預期，在人工智慧、高效能運算(HPC)及雲端資料中心需求帶動下，資通訊產品出口維持高成長態勢**。其次，護國神山台積電八月營收再度繳出亮眼成績，反映先進製程需求強勁，也顯示全球科技產業對AI晶片的投資熱潮仍在持續。台積電是全球AI供應鏈的核心，因此其營收與展望持續成長，對投資人信心具有重要支撐效果。

然而，儘管企業基本面表現穩健，市場仍面臨來自總體經濟的挑戰。其中最值得關注的，莫過於美國通膨問題遲遲未能完全解除。近月以來，美國經濟數據仍展現一定韌性，消費與就業表現優於市場預期，使得聯準會重啟升息。與此同時，美國十年期公債殖利率居高不下，反映市場擔憂通膨可能捲土重來。一旦殖利率持續攀升，勢必對高本益比的科技類股形成評價面壓力。

今年十一月即將登場的美國期中選舉，也是未來兩個月市場需要留意的重要事件。**從歷史經驗來看，美國期中選舉前夕往往伴隨政策不確定性升高，投資人傾向觀望，市場波動度也可能增加**。無論是財政政策、貿易政策或科技監管方向，都可能因選舉結果而產生變化。雖然選後不確定因素通常會逐步消除，但在投票結果尚未出爐之前，市場情緒難免受到壓抑，也是近期全球股市缺乏明確攻擊動能的原因之一。

策略上，若市場持續震盪，可採取分批布局方式逐步建立部位，避免一次性投入過多資金，整體而言，AI、高效能運算、先進製程等長期成長動能並未改變，**市場經歷短期震盪後，有機會逐步回歸基本面，中長線投資價值猶存，台股加權指數目標價預估維持5萬點的看法**。



資料來源：Cmoney，財經M平方，永豐投顧研究整理

投資聲明:本研究報告由永豐商業銀行提供，資料來源為永豐證券投資顧問股份有限公司，所載資料僅供參考，無法保證內容完整性或預測正確性，亦不作任何保證，資料內容若有變更，將不另行通知，客戶投資前應慎重考量本身風險承受度，並應自行承擔投資風險。投資均有風險，任何投資商品過去績效亦不代表未來績效之保證，且有可能受市場波動導致本金損失；若申購以外幣計價的投資商品應瞭解匯率變動風險亦有可能導致本金之損失。未經永豐商業銀行及永豐證券投資顧問股份有限公司同意，不得以任何形式沿用、複製或轉載本文件之內容。

2026年09月22日

主題趨勢報

SEMICON Taiwan 2026

SEMICON Taiwan 2026展會主軸明確聚焦於AI半導體、先進封裝與矽光子技術，反映全球半導體產業已從單純製程微縮進入系統整合與異質整合的新階段。根據SEMI最新預估，**2026年全球半導體設備市場規模將達1,659億美元，年增23.2%，2028年更可望上看2,295億美元創歷史新高**。其中測試設備產值年增31%，明顯高於封裝設備的9.6%，顯示HBM、高階AI晶片與先進封裝導致良率驗證需求快速增加，測試介面、探針卡及相關設備已成為產業成長速度最快的環節。

本次六大展區以AI半導體與先進封裝、矽光子最具價值。AI運算需求爆發帶動CoWoS、SoIC、EMIB、FOPLP等先進封裝技術快速發展，封裝尺寸不斷擴大，對載板、散熱材料、設備與測試技術提出更高要求。相較之下，量子技術仍偏向長期題材，化合物半導體（SiC、GaN）則因終端市場動能不足，基本面對疲弱，因此展覽熱度未必代表實際需求回升。

台積電在展會中特別強調AI Scaling已由製程微縮轉向先進封裝與光互連。隨AI算力每兩年約成長3倍，但I/O頻寬僅成長約1.4倍，形成所謂「I/O Wall」瓶頸，因此推出COUPE光互連平台，將光學引擎直接整合至封裝中，以大幅降低功耗與傳輸延遲。未來光互連將與CoWoS及SoIC深度整合，推動矽光子從元件製造延伸至封裝、測試及系統整合。這也意味著受惠範圍將不再局限於光通訊廠商，而是擴展至雷射元件、FAU、光學封裝及相關測試設備廠。

另一大趨勢則是大型封裝化。日月光指出AI封裝已朝超大尺寸發展，未來封裝尺寸將突破傳統光罩限制，FoCoS、FoCoS-Bridge及面板級封裝（PLP）技術的重要性持續提升。隨封裝面積增加，翹曲控制、熱管理與測試難度同步提高，帶動測試介面、Socket、Handler與量測設備規格全面升級。尤其矽光子CPO量產之後，封裝與測試將成為最具技術門檻的環節，相關設備商有望取得長期成長機會。



Semicon Taiwan 2026六大主題區			
主題區	核心命題	觀察重點	評價
AI 半導體與先進封裝	由微縮轉向 3D 堆疊與水平整合、Chiplet	CoWoS、SoIC、EMIB、FOPLP 各廠解決方案進度	具基本面
矽光子	光取代銅，解 AI 機房顯電與功耗瓶頸	台積電、GFS 等廠商解決方案的商用進度	具基本面
量子技術	首度設專區（超導、離子阱、退火）	基本面對薄弱，流動度偏高	純題材
智慧晶圓製造	AI 生產系統、數位分身、協作機器人，訴求提升 15-20% 效率	廠務自動化與機器人補強，緊接自動化展後邊際效用遞減	中性
化合物半導體	SiC / GaN 應用於電動車與 6G	基本面偏弱	偏弱
綠色製造	研管理、水回收、能效	法規驅動，營收貢獻速度慢	影響有限

資料來源：Cmoney，永豐投顧研究整理

投資聲明:本研究報告由永豐商業銀行提供，資料來源為永豐證券投資顧問股份有限公司，所載資料僅供參考，無法保證內容完整性或預測正確性，亦不作任何保證，資料內容若有變更，將不另行通知，客戶投資前應慎重考量本身風險承受度，並應自行承擔投資風險。投資均有風險，任何投資商品過去績效亦不代表未來績效之保證，且有可能受市場波動導致本金損失；若申購以外幣計價的投資商品應瞭解匯率變動風險亦有可能導致本金之損失。未經永豐商業銀行及永豐證券投資顧問股份有限公司同意，不得以任何形式沿用、複製或轉載本文件之內容。

蘋果新機發表會，摺疊機、iPhone 18 Pro亮相

Apple於2026年秋季發表會正式推出首款摺疊手機iPhone Duo，同時發表iPhone 18 Pro系列、Apple Watch Series 12及AirPods 5等新品。其中，市場最關注的焦點無疑是Apple首度跨入摺疊手機市場，象徵智慧手機產業競爭進入新階段，也為沉寂多年的手機市場注入新的成長動能。

從產品規格來看，iPhone Duo定位明顯鎖定高階用戶。其採用5.4吋外螢幕與7.6吋內螢幕設計，搭載2奈米A20 Pro處理器、鈦金屬機身、第二代Ceramic Shield保護玻璃，以及由超過百個零件組成的精密轉軸系統，售價更高達1,999美元。相較於過去市場上的摺疊手機產品，Apple不僅強調硬體規格，更著重軟體生態系整合與使用者體驗，特別是在iOS 27的多工處理及Apple Pencil支援下，試圖提升摺疊手機的生產力價值，藉此與一般旗艦手機區隔。

然而，值得注意的是，Apple此次新品發表並非全面利多。iPhone 18 Pro及Pro Max售價全面調漲100美元，高階機種起售價已突破1,200美元門檻。雖然新機採用2奈米晶片及首度導入實體可變光圈設計，但整體規格升級幅度相較過往世代並不算特別突出。在全球智慧手機市場逐漸成熟、換機週期拉長的情況下，價格上漲是否會壓抑消費者換機意願，仍有待後續銷售數據驗證。尤其標準版iPhone 18延後上市，對於整體出貨節奏及全年銷量恐形成一定壓力。

對資本市場而言，此次發表會最大的投資意義，在於摺疊手機有望帶動零組件規格升級與供應鏈價值重估。過去Android陣營已證明摺疊手機需要更多精密機構件、高階材料與特殊零組件，因此產品單價及零件平均售價 (ASP) 往往高於傳統手機。Apple加入後，將有助擴大摺疊手機市場規模，並推升相關供應鏈長期成長空間。

iPhone規格比較				
規格與功能	iPhone 18 Pro	iPhone 18 Pro Max	iPhone 17 Pro	iPhone 17 Pro Max
螢幕尺寸	6.3 吋	6.9 吋	6.3 吋	6.9 吋
處理器晶片	Apple A20 Pro (2nm)	Apple A20 Pro (2nm)	Apple A19 Pro (3nm)	Apple A19 Pro (3nm)
主相機鏡頭	4800 萬像素 (實體可變光圈)	4800 萬像素 (實體可變光圈)	4800 萬像素 (固定光圈)	4800 萬像素 (固定光圈)
動態島功能	縮小化動態島 (支援 3 項即時動態)	縮小化動態島 (支援 3 項即時動態)	標準動態島	標準動態島
容量規格	256GB / 512GB / 1TB / 2TB	256GB / 512GB / 1TB / 2TB	256GB / 512GB / 1TB	256GB / 512GB / 1TB / 2TB
美金起售價 (256GB)	\$1,199 USD 起	\$1,299 USD 起	\$1,099 USD	\$1,199 USD

資料來源：永豐投顧研究整理